

EV Group Hybrid Bonding and Nanoimprint Lithography Solutions to be Highlighted at SEMICON TAIWAN 2023 – August 31, 2023

a a m News

EVG將在SEMICON Taiwan 2023國際半導體展上 凸顯混合接合與奈米壓印微影解決方案



凸顯EVG針對異質整合在混合接合與檢測解決方案的突破性能力 以及超額光學及擴增實境波導管製造的奈米壓印微影解決方案

台北・2023年8月30日 ─微機電系統(MEMS)、 奈米科技與半導體市場的晶圖 接合暨微影技術設備領導廠商EV Group(EVG),今天宣布將在下週於2023國際半導 體展(SEMICON Taiwan 2023)中,凸顯其3D/異質整合及擴增實境(AR)波導管製 造約全新發展,而這些進展是由該公司先進之晶圖到晶圖(W2W)與晶粒到晶圖(D2 W)混合接合、檢測與奈米壓印微影(NIL)解決方案所促成。EVG將在2023國際半導 體展中,發表以下演說:

「探索奈米壓印微影、超穎透鏡與擴增實境/虛擬實境的綜效」(微機電系統暨感測器論壇-9月5日週二下午2點,台北南港展覽館一館5樓505ab室)

EVG業務發展總監Thomas Uhrmann,將針對奈米壓印微影的多功能性與近期成就提 出概述,並聚焦在超穎透鏡與AR波導管的製造,以及該技術能力正如何快速崛起中。 他將深入探討如何透過將主製程技術、成熟的複製工藝和專用的光學材料相匹配,以實 現這些精密結構的高效擴展。

「3D與異質整合檢測的進展」(TechXPOT舞台-9月6日週三下午2點,台北南港展 覽館一館4樓L1100攤位)

EVG台灣資深應用暨技術部工程師Jason Li,將針對各種應用當前的疊層檢測需求提出 概述,包括晶粒到晶圓、晶圓到晶圓以及新型封裝方法的晶粒偏移,如搭載自適應圖案 的無光罩微影,瞭解並應對這些檢測需求,對於推進3D與異質整合技術及達成高效率 且可靠的製造良率,至關重要。 「藉由晶圓到晶圓接合實現次世代邏輯與記憶體製造:全面的觀點」(IC論壇-9月8
日週五下午2點;台北南港展覽館一館4樓402室)

EVG技術執行總監Paul Lindner,將針對次世代記憶體與邏輯裝置相關的當前產業趨勢 提出概述,並聚焦在3D整合如何推動全新的技術進步。其中包括結合熔融接合與混合 接合的討論,以及超薄薄膜的分離技術,而該技術代表先進半導體裝置的全新微影微 縮。

I 「突破界線:探討用於3D-IC整合使用之混合晶片對晶圓與晶圓對晶圓接合」(異質 整合全球高峰會-9月8日週五下午2:40;台北南港展覽館一館4樓401室)

Thomas Uhrmann博士,將針對晶圓到晶圓與晶粒到晶圓混合接合的當前產業趨勢與 技術進展提出概述,包括關鍵技術差異化因素及整合場景。下一個技術轉型將導入通用 的高密度互連技術,從而導致一個新的整合過程。整合流程的選擇將視互連密度、晶片 大小、系統良率與成本等因素而定。

EVG異質整合解決方案

EVG的晶圓接合、微影與檢測解決方案,促成了先進封裝(包括背照式CMOS影像感測 器與其它3D-IC堆量裝置)、微機電系統與化合物半導體等領域中技術創新的開發與量 產。EVG有關異質整合與晶圓層級封裝的技術領先地位實例,包括下列近期的技術突 破:應對3D裝置整合所需的混合接合;應對未來3D-IC封裝需求的晶圓接合對準技 術;為先進封裝消除玻璃基板並促成薄層3D堆疊的紅外線雷射釋放技術;供扇出型晶 圓級封裝(FOWLP)使用的無光罩碟光技術;以及支援晶圓級光學(WLO)的奈米壓 印微影。

此外,EVG同時也與整個技術供應鏈的企業及研究團隊合作,以便為各式各樣的汽車、 醫學、工業及家庭娛樂應用開發出量產的解決方案,來驅動半導體、感測器與光子學領 域的創新。

參觀EVG在2023國際半導體展的展出

參與2023國際半導體展的朋友,若有興趣瞭解更多有關EVG以及其針對異質整合提出 的全套晶圓接合、微影與檢測的解決方案,歡迎您於9月6日至9月8日前往台北南港展 覽館,造訪EVG的EVG-JOINTECH Booth L0316(台北南港展覽館一館4樓)。

關於EV Group(EVG)

EVG是全球半導體、微機電、化合物半導體、電源元件和奈米科技應用的晶圓製程 解決方案領導廠商,主要產品包括晶圓鍵合、晶圓薄化、微影/ 奈米壓印微影技術 (NI L) 和檢測設備,以及光阻塗佈機、顯影機、晶圓清洗和檢測設備。EVG成立於1980 年,藉由一個完備的全球網絡資源為全球的客戶和合作夥伴提供服務。更多相關資訊請 參考公司網站:www.EVGroup.com。

https://n.yam.com/Article/20230831804015